

300mmウェハカセットレス洗浄装置

<概要>

本装置はファイナルポリッシュ後の化学研磨工程で使用する装置です。特徴は25枚のWfの隙間に25枚を入れハーフピッチにし50枚を一括処理します。65nm/5個の高精浄度を達成しています。

<主な仕様>

1. 被洗浄物 : 300mm 厚み 0.75 t
2. 処理方法 : カセットレスによるDip処理
3. 処理速度 : 50枚/5min (可変)
4. 装置内精浄度 : 0.1 μ m クラス1
5. パスライン : FL+900 \pm 5mm フープによる手動セット
6. 搬送方式 : 前面搬送

<写真>



外観



洗浄槽